(11)Publication number:

2003-293055

(43) Date of publication of application: 15.10.2003

(51)Int.CI.

C22C 5/06 C23C 14/24

C23C 14/34

G11B

(21)Application number: 2002-105435

(71)Applicant: SUMITOMO METAL MINING CO LTD

(22)Date of filing:

08.04.2002

(72)Inventor: SHIMIZU JUICHI

(54) SILVER ALLOY THIN FILM AND SILVER ALLOY FOR FORMING THIN FILM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a silver alloy thin film which has a high reflectivity, is excellent in the uniformity of the reflectivity, and also has a reduced change with the lapse of time, i.e., the one which is suitably used for a reflection film of an optical recording disk dealing with high recording density or of a display device dealing with a high definition screen, and to provide a silver alloy which is suitably used for forming the silver alloy thin film.

SOLUTION: The silver alloy thin film contains 0.01 to 0.1 atomic % of one or more kinds of metals selected from Pd and Pt, and, if required, containing one or more kinds of metals selected from Zn, Mg and Cu, and the balance Ag with inevitable impurities. The silver alloy suitably used for the production of the same has the same componential composition.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-293055 (P2003-293055A)

(43)公開日 平成15年10月15日(2003.10.15)

(51) Int.Cl.7	識別記号	F I デーマユート*(参考)
C22C 5/0	6	C 2 2 C 5/06 Z 4 K 0 2 9
C 2 3 C 14/2	1	C 2 3 C 14/24 E 5 D 0 2 9
14/3-	4	14/34 A 5 D 1 2 1
G11B 7/2	4 538	G11B 7/24 538E
7/20	5 3 1	7/26 5 3 1
		審査開求 未請求 請求項の数7 OL (全 5 頁)
(21) 出願番号	特顧2002-105435(P2002-105435)	(71)出題人 000183303
		住友金属鉱山株式会社
(22) 出顧日	平成14年4月8日(2002.4.8)	東京都港区新橋5丁目11番3号
		(72)発明者 清水 寿一
		東京都青梅市末広町1丁目6番1号 住友
		金属鉱山株式会社電子事業本部内
		(74)代理人 100084087
		弁理士 鴨田 朝雄 (外1名)
		Fターム(参考) 4K029 BA22 BD00 BD02 BD09 CA01
		CA05 DB04 DC04
		5D029 WA13
		5D121 AA05 EE02 EE03 EE08 EE09
		EE14
•		

(54) 【発明の名称】 銀合金薄膜および薄膜製造用銀合金

(57)【要約】

【解決手段】 上記銀合金薄膜は、PdおよびPtのうちの1種以上を0.01~0.1原子% 必要によりZn、MgおよびCuのうちの1種以上を0.1~5原子%含み、残部がAgおよび不可避不純物からなる。また、上記製造に用いて好適な銀合金は、上記と同様の成分組成を有する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 PdおよびPtのうちの1種以上を0.01~0. 1原子%含み、残部がAgtoよび不可避不純物からなる銀合 金薄膜。

1

【請求項2】 PdおよびPtのうちの1種以上を0.01~0. 1原子% 並びにZn、MgおよびCuのうちの1種以上を0.1 ~5原子%含み、残部がActaよび不可避不純物からなる銀 合金薄膜。

【請求項3】 反射率が90%以上である請求項1~2の いずれかに記載の銀合金薄膜。

【請求項4】 反射膜用、電極膜用または遮光膜用であ る請求項1~3のいずれかに記載の銀合金薄膜。

【請求項5】 PdおよびPtのうちの1種以上を0.01~0. 1原子%含み、残部がAgtoよび不可避不純物からなる薄膜 製造用銀合金。

【請求項6】 PdおよびPtのうちの1種以上を0.01~0. 1原子% 並びにZn、MgおよびCuのうちの1種以上を0.1 ~5原子%含み、残部がAgおよび不可避不純物からなる薄 膜製造用銀合金。

【請求項7】 スパッタリングターゲット用または蒸着 20 源用である請求項5~6のいずれかに記載の薄膜製造用 銀合金。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、各種の光記録ディ スクや表示デバイス装置の反射膜などに用いて好適な銀 合金薄膜、および該銀合金薄膜の製造に用いて好適な銀 合金に関する。

[0002]

【従来の技術】ディスクに記録した情報を光信号を用い 30 み、残部がAgおよび不可避不純物からなる。 て読み取るCD、DVD、MODなどの各種光記録ディスクや、 画像情報を表示するためのLOD、PDP、ELなどの各種表示 デバイス装置には、スパッタリングや蒸着などの方法に より形成された厚さ数百人~数千人の反射膜が用いられ ている。

【0003】この反射膜には、反射率が高いこと、反射 率が面内で均一なこと、反射率の経時変化が小さいこと などの特性が要求される。そのため、従来は、A1、Au、 Agおよびそれらの合金からなる金属薄膜が主として用い られてきた。

【0004】近年、光記録ディスクや表示デバイス装置 の高記録密度化、高精細化に対応して、反射率がより高 く、反射率の均一性がより優れた反射膜に対する要求が 髙まってきている。

【0005】上記AIおよびAI合金からなる反射膜は、反 射率が低いため、上記要求特性を満足できないことが明 らかになっている。また、上記AuおよびAu合金からなる 反射膜は、上記要求特性を満足できる可能性はあるが、 価格が非常に高いため、市販の光記録ディスクや表示デ バイス装置に用いることが困難である。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】前記従来の反射膜のう ちのAgasよびAg合金からなる反射膜は、反射率が高いと いう点で好適な材料である。しかしながら、特に純Agか らなる反射膜は、反射率の均一性や経時変化の点で、前 記要求特性を十分に満足させることができなかった。

【0007】そとで、本発明の目的は、上記問題点を解 決し、反射率が高く、反射率の均一性が優れ、かつ経時 変化が小さい銀合金薄膜、換言すれば高記録密度対応の 光記録ディスクや髙精細画面対応の表示デバイス装置の 10 反射膜に用いて好適な銀合金薄膜を提供すること、およ び該銀合金薄膜の製造に用いて好適な銀合金を提供する ととにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明の銀合金薄膜は、 一特徴によれば、PdおよびPtのうちの1種以上を0.01~ 0.1原子%含み、残部がAgtaよび不可避不純物からなる。 反射率は90%以上が好ましく、95%以上であることがさら に好ましい。

【0009】本発明の銀合金薄膜は、他の特徴によれ ば、PdおよびPtのうちの1種以上を0.01~0.1原子% 並 びに Zn、MaおよびCuのうちの1種以上を0.1~5原子%含 み、残部がAgおよび不可避不純物からなる。反射率は90 %以上が好ましく、95%以上であることがさらに好まし

【0010】本発明の銀合金薄膜は、反射膜用、電極膜 用または遮光膜用に適している。

【0011】本発明の薄膜製造用銀合金は、一特徴によ れば、PdなよびPtのうちの1種以上を0.01~0.1原子%含

【0012】本発明の薄膜製造用銀合金は、他の特徴に よれば、PdおよびPtのうちの1種以上を0.01~0.1原子 % 並びにZn、MgおよびCuのうちの1種以上を0.1~5原 子%含み、残部がAgaとよび不可避不純物からなる。

【0013】本発明の薄膜製造用銀合金スパッタリング ターゲット用または蒸着源用に適している。

[0014]

【発明の実施の形態】本発明者は、上記目的を達成する ため種々の検討を行った結果次の(1)~(3)の事項 40 を見出し、本発明に到達した。

【0015】(1)純Agの反射膜で反射率の均一性が劣 るのは、スパッタリング法で該反射膜を形成する際に原 料として用いるターゲットの結晶粒が粗大なため、該反 射膜の(イ)膜厚のばらつきおよび(ロ)Ao結晶粒径の ばらつきが大きくなりやすいからである。

【0016】(2)純Agの反射膜で反射率の経時変化が 大きい(純Ag反射膜の安定性が劣る)のは、(イ)耐熱 性に関し、反射膜の使用環境下で、特に温度の影響によ り、該反射膜中のAg結晶粒が粗大化しやすい、(ロ)耐 50 食性に関し、主としてAgの硫化によって該反射膜が腐食 されやすいからである。

【0017】(3)上記(1)および(2)の対策とし て、Pd、Pt、Zn、Mg、Cuの添加が有効である。

【0018】すなわち、本発明の銀合金薄膜は、その一 特徴によれば、PdおよびPtのうちの1種以上を0.01~0. 1原子%含み、残部がAgおよび不可避不純物からなる。ま た、他の特徴によれば、PdおよびPtのうちの1種以上を 0.01~0.1原子% 並びにZn、MgおよびCuのうちの1種以 上を0.1~5原子%含み、残部がAgおよび不可避不純物か らなる。当該銀合金薄膜は、反射率が高く、反射率の均 10 一性が優れ、かつ経時変化が小さい。

【0019】なお、反射率の均一性が優れるとは、具体 的には、反射率のばらつきが少ないということである。 ととで反射率のばらつきの意味は、次の通りである。 す なわち、分光光度計により、波長650nmの光を用い て、薄膜試料中の相異なる場所の30点で反射率を測定 する。こうして得た30点のデータの最大値と最小値と の差を反射率のばらつきとする。

【0020】本発明の銀合金薄膜は、例えば光記録ディ スクの反射膜用や、表示デバイス装置の反射膜用、電極 20 れない。一方、5原子%を超えると、反射率の低下が大き 膜用、遮光膜用である。

【0021】本発明の薄膜製造用銀合金は、その一特徴 によれば、PdおよびPtのうちの1種以上を0.01~0.1原 子%含み、残部がAoなよび不可避不純物からなる。ま た、他の特徴によれば、PdおよびPtのうちの1種以上を 0.01~0.1原子% 並びにZn、MaおよびCuのうちの1種以 上を0.1~5原子%含み、残部がAgおよび不可避不純物か らなる。

【0022】本発明の薄膜製造用銀合金は、例えばスパ ッタリングターゲット用、蒸着源用である。

【0023】本発明の銀合金薄膜は、本発明の薄膜製造 用銀合金を原料としてスッパタリングあるいは蒸着で形 成され、PdおよびPtのうちの1種以上を含むか、あるい は、PdおよびPtのうちの1種以上、並びにZn、Mgおよび Cuのうちの1種以上を含む。本発明の銀合金薄膜が、反 射率が高く、反射率の均一性、耐熱性および耐食性が優 れる理由は、次の(1)~(4)の通りである。

【0024】(1)本発明の薄膜製造用銀合金は結晶粒 が微細化されている(平均結晶粒径:200μ m以下)の で、形成された第1発明および第2発明の銀合金薄膜 は、膜厚のばらつきが小さく、従って反射率の均一性が 優れる。反射率が均一になれば、銀合金が本来有する高 反射率が実現する。

【0025】(2)本発明の銀合金薄膜に含まれるPdta よびPtは、該薄膜中の結晶粒を微細化し、さらに反射膜 中結晶粒の粗大化を抑える(該薄膜の結晶粒径のばらつ き、およびそのばらつきの経時変化を小さくする)。従 って、Pt、Pdのうちの一種以上を添加することによ り、反射率のばらつきを小さくし(反射率の均一性を向 上させ、反射率を高くし)、該薄膜の耐熱性を向上させ 50

【0026】(3)本発明の銀合金薄膜に含まれるPdお よびPtは、該薄膜の耐食性をも向上させる。

4

【0027】(4)第2発明の銀合金薄膜に含まれるZ n、MgおよびCuは、耐食性をさらに向上させる。

【0028】PdおよびPtのうちの1種以上が0.01原子% 未満では、該1種以上の上記作用効果が十分得られず、 一方、0.1原子%を超えると、該1種以上の上記作用効果 がより大きくならない。また、0.1原子%を超えると、特 に表示デバイス装置用途で要求されるエッチング性が低 下する。そのために、表示デバイス装置の製造に好適な エッチャーでエッチングをして薄膜にパターンを形成す ることが困難になる。なお、この際エッチング力の強い エッチャーを用いればエッチングは可能である。しか し、その場合には薄膜以外の材料も同時にエッチングし てしまうため、製造工程が複雑になってコストアップを 招く。

【0029】Zn、MgおよびCuのうちの1種以上が0.1原 子%未満では、該1種以上の耐食性向上作用が十分得ら くなる。

【0030】なお、本発明の銀合金薄膜は、光記録ディ スクや表示デバイス装置の反射膜用として好適である。 また、反射率が高い点、耐食性に優れる点、エッチング 性に優れる点、さらに純Agに近い純度を有し電気抵抗が 低い点から、表示デバイス装置の電極膜用、遮光膜用と しても好適である。

【0031】本発明の銀合金薄膜は、本発明の薄膜製造 用銀合金であるスパッタリングターゲットや蒸着源など 30 の薄膜製造原料から形成することができる。この原料の 成分組成は、形成したい銀合金薄膜の成分組成とほぼ同 様にすればよい。

・【0032】本発明の薄膜製造用銀合金は、粉末冶金法 や溶解鋳造法などの公知の合金製造方法により、適当な 塑性加工条件、加熱条件などで製造することができる。 [0033]

【実施例】 [実施例1~12、比較例1~6] 99.99原 子%の純度を有する塊状のAg、Pd、Pt、Zn、MgおよびCu を配合し、真空溶解炉で鋳塊を溶製した。この鋳塊につ 40 いて熱間圧延した後に冷間圧延と焼鈍を繰り返すことに より、ターゲットを得た。このターゲットについて化学 分析を行い、平均結晶粒径を測定した。なお、平均結晶 粒径は断線組織観察によった。これらの結果を表1に示

【0034】次に、上記ターゲットを用いて、マグネト ロンスパッタ法により、10cm角のガラス基板上に、厚さ 3000人の薄膜試料を形成した。形成した薄膜試料につい て化学分析を行い、反射率、反射率均一性、耐熱性、耐 食性およびエッチング性を測定・評価した。

【0035】反射率の測定は、分光光度計により、波長

650mmの光を用いて、1つの薄膜試料中の相異なる場所の30点で行った。得られたデータから平均値を求め、それを薄膜試料の反射率とした。また、得られたデータからばらつきを求め、そのばらつきが小さいほど反射率の均一性が良好と評価した。なお、ばらつきは、30点の測定値の最大値と最小値との差である。

【0036】上記薄膜試料(成膜したまま)に500℃・1 0秒間の熱処理を施して得られた薄膜試料(加熱後)について、上記と同様に反射率を測定した。得られたデータから、平均値およびばらつきを求めた。そして、成膜 10 したままの試料についての平均値と加熱後の試料についての平均値とを比較し、また成膜したままの試料についてのばらつきと加熱後の試料についてのばらつきと加熱後の試料についてのばらつきとを比較した。つまり、耐熱試験による平均値の変化(差)およびばらつきの変化(差)を調べた。それによって、成膜したままの試料の耐熱性を総合的に評価した(平均値の変化およびばらつきの変化が小さいほど耐熱性が高

*【0037】耐食性については、成膜したままの試料を Zns粉末中に室温で1時間放置した後に、上記と同様に反射率を測定した。そして、このように放置した反射率が成膜したままの反射率から減少した減少分(差)の、成膜したままの反射率に対する百分率(減少率(%))を求めた。この減少率(%)が小さいほど耐食性が良好と評価した。

【0038】エッチング性については、フォトレジストを用いてエッチングバターンを形成した後に、硝酸第2セリウムアンモン系水溶液を用いてエッチング処理した。そして、バターン通りにエッチングされかつ膜剥離や膜腐食が見られない場合をエッチング性「良」と、そうでない場合をエッチング性「不良」と評価した。

【0039】以上のようにして得られた結果を表2に示す。なお、薄膜試料の化学分析は、ターゲットの化学分析とほぼ同等であった。

[0040]

k 【表1】

(s) .

			<u> </u>		135		
	ターゲット 組成(原子%)					平均結晶粒径	
	Pd	Pt	Zn	Mg	Cu	Ag	(μm)
実施例1	0.01	-	-	-	-	残	98
実施例2	0.05	-	-	-	-	"	79
実施例3	0.10	-	_	-	-	"	70
実施例4	-	0.01	-	-	-	"	101
実施例 5	-	0. 05	-	-	-	7	84
実施例6	-	0.10	-	-	-	n	72
実施例7	0.05	-	-	-	0.1	,,	57
実施例8	0.05	-	-	-	5. 0	n	51
実施例 9	0. 05		0.1	-	-	,,	80
実施例10	_	0.05	5.0	-	-	я	61
実施例11	-	0.05	-	0. 1	-	"	82
実施例12	-	0.05	-	5.0	-	,,	56
比較例1	-	-	-	-	-	7	213
比較例2	0.5	-	-	-	-	"	49
比較例3	-	0.5	-	-	-	7	57
比較例4	0. 05	-	7.0	-	-	"	50
比較例 5	0.05	-	-	7.0	-	"	47
比較例6	0.05	-	-		7.0	"	44

(注)「一」は無添加。

[0041]

【表2】

. •

	成膜し	成膜したま 加熱後の反				
	まの反射率		射率(%)		耐食性(反	エッチ
	(%)				射率の減	ング性
:	平均	ばら	平均	ばら	少率、%)	
	値	つき	值	つき		
実施例1	97.5	1.6	97.4	2.6	11	良
実施例 2	97.4	1.3	97.4	2.0	11	וו
実施例3	97. 7	0. 9	97.8	1.3	10	B
実施例 4	97. 3	1.7	97.3	2. 5	11	n
実施例 5	97.3	1.2	97. 2	2. 0	11	"
実施例 6	97.4	1.1	97. 4	1.3	10	n
実施例7	97.1	1.1	96. 9	1.8	11	n
実施例8	94. 9	0.9	94.0	1.3	. 8	"
実施例 9	96.8	1.2	95.4	2. 3	10	"
実施例10	91.0	1.5	90.0	2. 9	6	"
実施例11	96.9	1.0	96.9	1.7	10	"
実施例12	91.6	1.6	90.8	1.6	5	n
比較例1	97.3	4.2	97.3	10.1	12	"
比較例2	97.6	0.8	97. 5	1.0	9	不良
比較例3	97.6	0.8	97. 7	1.1	10	"
比較例4	82. 2	2.0	79.7	2.8	5	良
比較例 5	84.6	2.3	83. 6	2.0	3	77
比較例 6	86.0	1.8	84. 9	1.8	6	77

【0042】以上の結果から次の(1)~(6)のことが分かる。

【0043】(1)実施例1~12では、反射率が高く、反射率の均一性に優れ、加熱や酸による反射率の変化および反射率は5つきの変化が小さく(耐熱性および耐食性に優れ)、しかもエッチング性に優れる反射膜が得られている。

【0044】(2)比較例1では、PdやPtが添加されていないためにターゲットの結晶粒が粗大になり(平均結晶粒径:213µm)、薄膜の反射率均一性および耐熱性が低下している(反射率ばらつきの変化(差)が大きい(5.9%))。

【0045】(3)比較例2、3では、Pd(比較例2) およびPt(比較例3)が多すぎるために、これらの薄膜 のエッチング性が低下している。

【0046】(4)比較例4では、Znが多すぎるため

に、薄膜の反射率および耐熱性が低下している(反射率 30 平均値の変化(差)が大きい(2.5%))。

【0047】(5)比較例5では、Mgが多すぎるため に、薄膜の反射率および反射率均一性が低下している。 【0048】(6)比較例6では、Cuが多すぎるため に、薄膜の反射率が低下している。

[0049]

【発明の効果】以上の説明から明らかなように、本発明によれば、反射率が高く、反射率の均一性が優れ、かつ経時変化が小さい銀合金薄膜、換言すれば高記録密度対応の光記録ディスクや高精細画面対応の表示デバイス装置などの反射膜、電極膜、遮光膜などに用いて好適な銀合金薄膜を提供することができる。また、このような銀合金薄膜の製造に用いて好適な銀合金をも提供することができる。